

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

## 翰博高新材料(合肥)股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	开源证券：祁海超 开源证券：向俊儒
时间	2026年6月24日
地点	公司会议室线上电话会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：潘大圣 战略投资关系代表：詹铖铖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司的产品结构和主要业务。</p> <p>答：公司以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为愿景，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体，已发展成为半导体显示面板背光显示模组及重要零部件的一站式综合方案提供商。公司的主要产品包括背光显示模组，以及导光板、精密结构件、光学材料等背光显示模组的相关零部件，可以广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR等终端产品领域。</p>

凭借多年积累的技术及经验，公司的产品已广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载显示、医疗显示器及工控显示器等终端产品，是国内产品种类较为齐全的背光显示模组厂商之一。目前，公司已掌握轻薄化、窄边框、异形屏及高亮度背光显示模组的相关技术并已实现量产。同时，公司加大研发投入，积极布局 Mini-LED 相关技术，开发出具有高度可靠性和稳定性的 Mini-LED 显示模块。公司已成长为同时具备背光显示模组设计、光学开发、精密结构件、光学材料及胶粘制品等材料精加工及自动化生产能力的背光显示模组、LCM 模组厂商。通过与客户紧密合作，公司对于客户的核心需求、产品变动趋势、行业最新要求理解更为深刻，有助于公司贴近客户需求，研发并生产符合市场需求的产品，提高客户满意度，从而增强公司在行业内的竞争力。依靠在背光显示模组领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司持续创新并不断加大研发投入，加强技术人员培养和储备。

在产能布局与全球化发展层面，公司海外战略布局顺利落地见效，越南两大生产基地顺利完成客户资质与产品认证工作，跨境一体化生产体系初步成型，依托海外生产基地贴近海外市场需求，有效提升海外订单交付能力，进一步拓宽海外市场发展空间。公司持续深耕背光显示模组及智能座舱显示配套相关产业，在稳固核心主业发展的基础之上，公司积极挖掘新兴产业发展机遇，布局半导体领域湿电子材料业务，多元新兴业务有序推进落地，为公司后续长远发展培育全新业绩增长动能。

**2、请简要说明公司 2025 年及 2026 年第一季度的经营情况。**

答：2025 年行业市场环境逐步回暖，公司把握市场发展机遇，稳步推进各项经营规划，整体经营运行态势向好，经营

发展基本面持续向好。公司全年实现营业收入 32.77 亿元，同比大幅增长 39.64%，创下近年营收规模新高。公司相较上一年度实现大幅减亏，归母净利润亏损规模得到有效缩减，归母净利润-9,679.60 万元，同比减亏 54.94%，主营业务盈利水平正持续向好回升。由于公司新建投资项目的折旧增加导致制造费用增加，新建生产基地的产品生产尚处于产能爬坡阶段，受订单转量产的周期特性影响，产品分摊的固定成本、人工成本偏高，2025 年营业收入的增长未能完全覆盖新建投资项目带来的成本增量。公司毛利率与去年基本持平，但规模效应尚未充分释放，使得报告期归母净利润依旧为负值。但是公司在报告期内持续深耕背光模组市场，客户订单稳步增加。公司在报告期内推进降本增效工作，落地多项精细化管理举措，期间费用较去年虽有小幅增长，但增长比例远低于营业收入增幅。同时公司 2025 年经营性现金流净额 2.88 亿元，健康的现金流状况充分保障了公司日常生产运营、订单承接及项目建设等各类经营活动有序开展，为企业稳定经营筑牢资金根基。

2026 年第一季度，公司经营态势延续改善趋势，营收稳健增长。报告期内实现营业收入 9.27 亿元，同比增长 27.19%，营业收入增长速度较快，主要得益于下游需求回暖及订单规模持续扩大，背光显示主业出货量稳步提升。公司当季实现扣除非经常性损益后净利润 437.99 万元，同比增幅达 111.93%。整体来看，随着公司产能利用率进一步提升、车载显示等高附加值产品占比持续提升，以及半导体显示材料等新业务逐步落地，公司盈利能力有望延续修复态势。

### 3、越南工厂 2025 年运营情况如何？未来规划是什么？

答：为深化全球化布局发展，公司目前通过启动越南“双基地战略”——北江背光显示模组基地和胡志明精密结构件基地，构建覆盖东南亚的垂直产业链体系。北江基地聚焦背光源

及液晶模组的智能化生产，为全球头部面板制造商及系统集成商提供高精度配套产品；胡志明基地专注精密冲压、注塑结构件，服务于笔记本、车载及工业显示屏等领域。公司构建覆盖东南亚的垂直产业链体系，强化国际客户需求的快速响应能力，为全球头部面板制造商及系统集成商提供高品质的产品。双基地将与国内产业园联动形成跨境产业链闭环，服务全球客户，推动公司全球化战略布局。公司先后设立了翰维科技（越南）有限公司和峰诺材料（越南）有限公司两家子公司，形成了从精密结构件到背光模组的本地化制造能力。未来，公司将持续推进越南双基地建设，加快产能爬坡进度，逐步提升海外市场份额。

**4、公司 2025 年底参与设立合资公司芯东进，并通过该平台收购韩国东进在华相关资产，请说明截至目前本次收购事项整体推进进度。**

答：公司于 2025 年 12 月参股设立合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称“芯东进”），注册资本 4.4 亿元，其中公司持股 45%。芯东进作为收购韩国东进在华资产的主体平台，拟以 1.421 亿美元收购韩国东进及其全资子公司香港东进共同设立的特殊目的公司 70% 股权，标的核心资产包含韩国东进境内 9 家目标公司 100% 股权及 24 项相关专利。截至目前，东进世美肯（上海）新材料有限公司已设立，并作为项目公司完成全部境内 9 家目标公司股权等资产的归集。后续公司将按收购协议约定推进股权转让相关手续办理，完成后合肥芯东进将取得前述项目公司 70% 股权，本次收购交割相关工作正有序落地推进中。

**5、贵公司未来发展怎么考虑的？**

答：公司未来将紧密围绕半导体显示主营业务，在治理层面，将从内部生产优化与外部供应链两方面发力，加速新基地

	<p>产能利用率爬坡，建设垂直一体化体系，依托越南双基地推动全球化布局，持续提升运营效率与成本管控能力。在研发创新与人才建设层面，将进一步加大投入，打通技术研发到产业应用，同时完善人才梯队培养体系，优化薪酬激励与绩效管理，打造高素质核心团队，为未来发展提供坚实的组织保障。在业务层面，公司将持续聚焦半导体显示技术升级与迭代，重点包括超亮超薄背光模组、持续优化防窥导光板、车载量子点 LED 技术，以及碳纤维背板方案，强化产品上的差异化优势，提升模组制造的数智化升级。同时，公司加速布局车载连屏、异形屏等创新形态，提升产品在中高端车型的渗透率与业务市场份额，深化和 Tier1 供应商、车厂的合作。依托参股公司布局湿电子材料赛道，未来将构建从半导体显示到半导体材料的产品体系，为公司中长期发展打造新的增长引擎。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 6 月 24 日